

技術詞彙表

於本文件中，除非文義另有所指，本文件中使用的與本公司及我們的業務有關的若干詞彙的解釋及定義載於下文。該等詞彙及其涵義未必與標準行業定義或用法一致。

「A2」	指	應用程序性能等級2級，SD協會為microSD和SD存儲卡定義的性能分類，可保證最低持續隨機讀寫速度和基線順序寫入速度，該速度針對在智能手機和平板電腦等設備中運行應用程序和處理頻繁的隨機文件訪問而優化
「AEC-Q100 Grade 2/3」	指	汽車電子委員會(Automotive Electronics Council)制定的一套認證標準，用於確保電子元器件在汽車應用中的可靠性。其中，2級標準下的設備具備在-40℃至+105℃環境溫度範圍內可靠工作的資質，3級標準下的設備具備在-40℃至+85℃環境溫度範圍內可靠工作的資質
「AI」	指	人工智能
「AI PC」	指	AI驅動個人電腦，即整合專用AI硬件及軟件、能夠在本機執行AI模型的計算設備(包括高端筆記本電腦及新興的以AI為核心的智能手機)，藉此提供增強型智能功能、響應能力及以用戶為中心的AI功能，而無需完全依賴雲端處理
「BGA」	指	球柵陣列，一種集成電路封裝類型，其電氣連接通過封裝底部的焊球陣列實現，與傳統封裝相比，允許更多的輸入／輸出(I/O)連接
「年複合增長率」	指	年複合增長率

技術詞彙表

「芯片」	指	一種微型電子設備或組件，通過特定佈線方法將晶體管、二極管、電阻、電容及電感器等基本電路元件與半導體製造工藝互連，形成一個完整的電子電路，該電路形成在一個或幾個小型半導體晶圓或介質基板上，並被封裝在一個外殼內
「主控芯片」	指	一種專用微處理器，為閃存存儲介質提供驅動及高速數據傳輸，具有特定的外部接口及協議處理模塊，負責與主機通信，決定存儲產品的形式及類別
「CPU」	指	中央處理單元，電子產品的運算與控制核心
「DDR」	指	雙倍數據速率，由JEDEC推出的同步動態隨機存取存儲產品行業標準
「DRAM」	指	動態隨機存取存儲器，一種易失性存儲器，用於計算機及其他設備存儲正在使用或處理的數據，需要定期刷新以維持存儲的信息
「DRAM模組」	指	其存儲芯片採用DRAM技術的模組，即包含按標準外形尺寸排列的DRAM芯片的電路板，可直接插入系統
「嵌入式存儲」	指	集成到電子產品主系統中的存儲產品，具有高容量嵌入式NAND Flash解決方案或複合NAND與DRAM解決方案的特點，主要用於智能手機及平板電腦等設備
「eMCP」	指	嵌入式多芯片封裝，一種半導體封裝技術，將eMMC及LPDDR封裝在單個封裝內，在最小化空間的同時增加功能及性能，並增強芯片之間的連接性

技術詞彙表

「eMMC」	指	嵌入式多媒體卡，一個集成的非易失性存儲系統，由閃存及閃存控制器組成，主要用於便攜式設備，提供可靠高效的數據存儲及管理
「ePOP」	指	嵌入式封裝，一種半導體封裝技術，將eMMC及LPDDR集成在一個封裝內，並直接堆疊在CPU表面之上
「ERP系統」	指	企業資源規劃系統，一種通過實時數據，將財務、供應鏈及客戶管理整合至統一系統的系統，旨在實現業務流程簡化與數據一致性
「eSSD」	指	企業級固態硬盤，一種專為數據中心及企業計算環境設計的高性能、高耐用性固態存儲設備
「固件」	指	存儲在存儲器中的預安裝程序代碼，在閃存控制器內運行，負責存儲產品中的協議處理、數據管理及硬件驅動等核心任務
「閃存」	指	一種非易失性半導體存儲器芯片，即使在斷電時也能保留存儲的信息，具有可重複讀取、擦除及寫入的能力，被認為是存儲產品的一個主要類別
「閃存轉換層」	指	位於文件系統之下的一層，將主機側或文件系統的邏輯塊地址映射到閃存的物理地址(邏輯到物理的映射)
「晶圓製造商」	指	根據客戶提供的設計，在矽晶圓上製造集成電路、但不從事IC設計或品牌芯片銷售的半導體製造商

技術詞彙表

「全棧」	指	一種全面的工程或軟件開發方法，涉及掌握系統的所有層次，從硬件及底層固件到高級軟件及用戶界面，以創建集成且統一的解決方案
「GB」	指	千兆字節，一種數字信息存儲單位，約等於十億字節，通常用於量化計算機及其他電子設備的數據存儲容量
「集成電路」或「IC」	指	集成電路，一種使用半導體技術製造的微型電子設備或元件，將電路所需的所有晶體管、電阻、電容、電感器及其連接線集成到一個小型半導體晶圓(如硅芯片或基板)上
「智能JBOF」	指	智能快閃記憶體集群(Intelligent Just a Bunch of Flash)，一種面向存算分離與無盤數據中心架構的高性能全閃存存儲陣列。其在傳統「純磁碟機箱」JBOF基礎上，通過集成智能控制及加速單元，融入近存計算技術，實現閃存資源的池化管理，並為外部主機提供低延遲、高頻寬的數據存取服務。該架構尤其適用於AI、HPC及雲數據中心中大規模、數據密集及高併發的應用場景
「物聯網」	指	物聯網，一個由互連設備組成的網絡，這些設備通過互聯網相互通信及交換數據
「ISO 14001」	指	一項規定有效環境管理體系要求的國際標準，幫助組織改善其環境績效並減少環境影響

技術詞彙表

「ISO 26262」	指	一項關於批量生產道路車輛(不包括輕便摩托車)中安裝的電氣及／或電子系統功能安全的國際標準
「ISO 9001」	指	一項載列質量管理體系要求的國際標準，幫助組織持續提供滿足客戶及法規要求的產品及服務，並證明其具備相應能力
「JEDEC」	指	聯合電子設備工程委員會
「JIRA系統」	指	一個跟蹤研發項目進度的系統，用於在整個產品開發過程中進行高效的任務分配、問題跟蹤及跨團隊協作。
「延遲」	指	操作或請求開始與期望結果或響應之間的時間延遲，是各種電子系統及通信網絡性能及響應能力的關鍵因素
「LBIST」	指	邏輯內建自測試，自測試的一種形式(屬更廣泛的內建自測試BIST的一部分)，其中測試邏輯直接嵌入集成電路中，使IC能夠在不需外部自動化測試設備的情況下測試其內部數字邏輯電路
「LPDDR」	指	低功耗雙倍數據速率，由JEDEC推出的低功耗SDRAM產品的行業標準
「MB」	指	兆字節，一種數字信息存儲單位，約等於一百萬字節，常用於描述文件大小或存儲設備的容量
「MBIST」	指	存儲器內建自測試，一種嵌入式硬件機制，可使芯片對自身內部存儲器開展缺陷檢測
「Mbps」	指	兆比特每秒，一種數據傳輸速率單位，通常用於描述通信網絡及互聯網連接的帶寬或速度

技術詞彙表

「內存模組」	指	配備存儲芯片的電路板，可為臨時數據處理與程序運行提供解決方案，廣泛應用於計算及工業領域，涵蓋個人電腦、教育系統及工業自動化領域。
「存儲晶圓」	指	用於製造存儲產品的晶圓
「microSD」	指	SD卡的更小版本，用於手機及其他小型電子設備以增加存儲容量
「microSDHC」	指	微型安全數位大容量卡，一種由SD協會標準化的閃存卡格式，使用相同的緊湊型microSD物理格式，但支持SD規範中定義的更大存儲容量(特別是大於2GB和高達32GB)
「microSDXC」	指	微型安全數位擴充容量卡，一種由SD協會定義的閃存卡格式，支持大於32GB和高達2TB的存儲容量
「移動存儲」	指	便攜式存儲設備，如U盤及存儲卡；移動存儲產品主要用作安全攝像頭、汽車系統及高清攝影等應用中的數據傳輸及備份工具
「NAND Flash」	指	一種非易失性閃存技術及基於該技術的產品，通常用於數據存儲
「OSAT」	指	半導體委外封裝測試，將半導體產品生產流程中半導體器件的封裝測試等關鍵環節，外包予第三方服務供應商承接的業務模式
「封裝」	指	將裸芯片封裝為帶有外部外殼及引腳的成品芯片的過程，通過導線或其他互連方式實現與外部引腳的電氣連接，隨後進行密封處理

技術詞彙表

「PB」	指	千兆字節，一種數字信息存儲單位，約等於1000兆字節，通常用於量化計算機和其他電子設備中的數據存儲容量
「PCB」	指	印刷電路板，用於電子領域的一種板材，其通過從壓合在非導電基材上的銅箔蝕刻而成的導電通路、線路或信號跡線，實現電子元器件的連接
「PCI-SIG」	指	外圍組件互連專業組，負責指定外圍組件互連(PCI)、PCI-X和PCI Express (PCIe)計算機總線的電子工業聯盟
「PCIe」	指	PCI Express，一種高速接口類型，用於連接計算機內部的硬件組件，旨在取代舊的擴展總線標準
「便攜式固態硬盤」	指	一種小型外置存儲設備，採用固態存儲器實現數據存儲
「RTL」	指	寄存器傳輸級，一種設計抽象層，根據硬件寄存器之間的數字信號(數據)流以及對該等信號執行的邏輯操作來模擬同步數字電路
「SATA」	指	串行高級技術附件，一種採用串行連接的接口標準，廣泛用於將硬盤驅動器及固態硬盤等存儲設備連接至計算機主板，以實現數據傳輸
「SD」	指	安全數字存儲卡，一種非易失性存儲卡格式，適用於相機、智能手機及平板電腦等便攜式設備，用於數據存儲及傳輸
「SHR系統」	指	戰略人力資源系統，用於管理員工信息及組織信息以實現高效人力資源管理的系統。

技術詞彙表

「SMT」	指	表面貼裝技術，一種將電子元件直接安裝在印刷電路板表面的方法
「SODIMM」	指	小型雙列直插式存儲器模塊，一種外形緊湊的存儲器模塊，用於在空間有限的設備中提供系統RAM(隨機存取存儲器)，如筆記本電腦、小型PC和嵌入式系統
「固態硬盤」	指	固態硬盤，安裝在計算機或服務器內部的內置存儲組件，相比傳統硬盤驅動器，具備更出色的性能及可靠性
「T-box」	指	一種嵌入式車載系統，作為車輛內部網絡與外部無線網絡之間的網關
「TB」	指	太字節，一種數字信息存儲單位，約等於一萬億字節，通常用於量化計算機和其他電子設備中的數據存儲容量
「Type-A」	指	原始且最常見的USB連接器類型，從早期的USB 1.0/1.1、USB2.0、USB 3.x，到最新的USB規格，多代USB標準下的設備與外設均廣泛支持該接口
「Type-C」	指	由USB Implementers Forum (USB-IF) 制定的一種連接器標準，該標準定義了一種緊湊、可逆的24針連接器(插頭及端口)，可替代此前的傳統USB連接器(Type-A、Type-B以及Mini/Micro變體)
「UDIMM」	指	無緩衝雙列直插式存儲器模塊，一種計算機存儲器模塊，其中存儲器控制器直接與DRAM芯片接口，無需中間緩衝器或寄存器
「UFS」	指	通用閃存存儲，一種高性能、可擴展的閃存存儲規範，設計用於移動設備及消費電子產品，提供快速的數據傳輸速度及改進的能效

技術詞彙表

「UHS-I」	指	超高速第一代，由SD協會為SD存儲卡(包括SDHC和SDXC)指定的總線接口標準，可在標準SD總線接口上實現高達104 MB/s的理論最大傳輸速度
「uMCP」	指	基於UFS的多芯片封裝，一種半導體封裝技術，將UFS及LPDDR集成在單個封裝內，支持廣泛的功能及互連，具備高度的多功能性與適應性，可滿足各類應用場景需求
「USB」	指	通用串行總線，一種標準化接口，可實現計算機與外圍設備之間的通信及供電，促進各種電子設備之間的便捷連接及數據傳輸
「V30」	指	視頻速度等級30，由SD協會定義的性能分類，指示microSD或SD卡支持30 MB/s的最低持續寫入速度，使其適合連續高分辨率視頻錄製，如4K UHD
「晶圓」	指	用於製造集成電路的半導體薄片
「磨損均衡」	指	一種應用於固態硬盤及其他閃存類存儲設備的技術，可將寫入與抹除週期均勻分佈在整個存儲介質上，從而提高設備的整體壽命及耐用性
「ZB」	指	澤字節，一種數字信息存儲單位，約等於十億兆字節，常用於量化計算機及其他電子設備的數據存儲容量